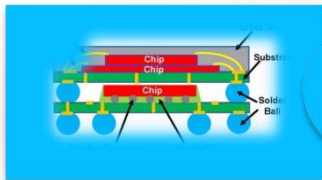


# 产品及应用

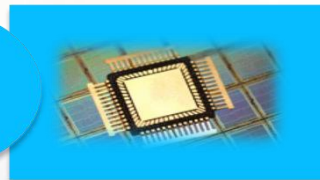
- ✓Laminate/FC
- ✓WLP
- ✓Fan Out/SIP



先进封装

锡球  
锡膏  
助焊膏

- ✓TO
- ✓DIP/SOP
- ✓QFN/QFP



传统封装

DA锡丝  
锡膏/助焊膏  
电镀锡球

焊锡材料

接插件

锡球  
锡膏



- ✓Socket
- ✓B2B Board

电子组装



- ✓Laser Weld
- ✓PCB/PCBA

锡球  
焊锡丝  
锡膏  
锡条

# 主要产品目录



类别	产品	常用规格	备注
传统类	电镀锡球	Ø 13mm、Ø 16mm、Ø 18mm、Ø 19mm、Ø 25mm	合金Sn99.95/99.99; 球径可定制
	无铅锡条	Sn100/Sn99.3Cu0.7/Sn99Ag0.3Cu0.7/Sn99.7Ag0.3 Sn96.5Ag3.0Cu0.5/Sn97Ag3.0	合金可定制; 低温、常温、高温
	无铅锡丝	Sn99.3Cu0.7/Sn99Ag0.3Cu0.7/Sn96.5Ag3.0Cu0.5	合金可定制; 有卤、无卤免洗; 线径: 最小0.1mm
锡球类	无铅锡球	Sn98.5Ag1.0Cu0.5/Sn98.25Ag1.2Cu0.5Ni0.05 Sn96.5Ag3.0Cu0.5/Sn95.5Ag4.0Cu0.5	合金可定制; 球径: 50um-889um
焊膏类	无铅锡膏	Sn99Ag0.3Cu0.7/Sn96.5Ag3.0Cu0.5/Sn42Bi58/Sn64Bi35 Ag1/Sn64.7Bi35Ag0.3/Sn90Sb10	合金可定制; 3号、4号、5号、6号 及超微粉
	助焊膏	TKWS400,TKWS300	含卤、无卤、水洗、免洗